

# イオンビーム表面平滑化によるウェハ常温接合技術

高木 秀樹\*, 倉島 優一\*, 前田 敦彦\*

Room-Temperature Wafer Direct Bonding Using Surface Smoothing by Ion Beam

Hideki TAKAGI\*, Yuichi KURASHIMA\*, and Atsuhiko MAEDA\*

\* 国立研究開発法人産業技術総合研究所集積マイクロシステム研究センター (〒 305-8564 茨城県つくば市並木 1-2-1 産総研つくば東)

\*National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) (AIST-Tsukuba-east, Namiki 1-2-1, Tsukuba, Ibaraki 305-8564)